

日本セラミックス協会関西支部 平成30年度支部セミナー 開催案内

- 【主催】 日本セラミックス協会関西支部
【共催】 大阪大学大学院工学研究科
【協賛】 日本化学会、電気化学会、高分子学会、応用物理学会、粉体粉末冶金協会、日本希土類学会
【日時】 2018年12月3日(月) 10:00~16:45
【会場】 大阪大学 银杏会館 阪急電鉄・三和銀行ホール
(吹田キャンパス：大阪モノレール「阪大病院前」徒歩5分)
(http://caren.eng.osaka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/access_to_ichokaikan.pdf)
【定員】 約80名

【テーマ】 組成・構造制御によるセラミックス材料の革新的物性発現

【プログラム】 (10:00~16:45)

- 10:00-10:05 開会挨拶
10:05-11:05 藤田 晃司 先生(京都大学)
「層状ペロブスカイトエンジニアリング：新規強誘電体・圧電体の開拓」
11:05-12:05 島ノ江 憲剛 先生(九州大学)
「酸化物半導体ガスセンサの材料設計 ーどこまで性能を引き出せるか」
(昼食休憩)
13:30-14:30 野口 仁 先生(富士フイルム株式会社)
「ビッグデータ・IoT時代を支えるバリウムフェライト磁性体を用いた大容量磁気テープの開発」
14:30-15:30 吉田 朋子 先生(大阪市立大学)
「半導体光触媒可視光応答性を制御する添加窒素化学状態」
(休憩)
15:40-16:40 辰巳砂 昌弘 先生(大阪府立大学)
「ガラス系イオニクス材料を用いた全固体リチウム電池の開発」
16:40-16:45 閉会挨拶

【参加費】 参加費・懇親会費の支払いは当日会場にて受け付けます。

- ・ セラミックス協会・協賛学協会員(一般)：6,000円
- ・ セラミックス協会・協賛学協会員(学生・シニア・永年継続会員)：2,000円
- ・ 支部賛助会員企業：1名無料 / 2人目からは6,000円(ただし、特級は2名無料)
- ・ 非会員：11,000円(講演予稿集代含む)

【懇親会】 (17:00~19:00) 银杏クラブ(银杏会館内) 会費 一般7,000円、学生5,000円

【参加申込方法】 ホームページ内の参加申込フォームに必要事項を記載の上、世話役(大阪大学 田村)までE-mail添付にて送付

【申込・問合せ先】

大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻 田村真治

TEL: 06-6879-7353, E-mail: shinji@chem.eng.osaka-u.ac.jp

【申込締切】 2018年11月26日(月) <定員になり次第締切>